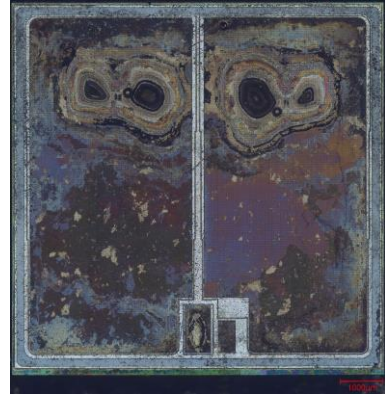


Si-IGBT (750V) Danfoss製 (智己汽車 L7(2022)搭載) パワーモジュール構造解析レポート



モジュール外観



チップ外観

製品概要

型番: DP700B750T105502

- ・智己汽車 L7(2022年 3月)のインバーターユニットに搭載のパワーモジュール。
- ・Danfoss(デンマーク)製 車載用 2in1 Si-IGBT Module (Vces750V Ic700A) ※マーキングからの推定
- ・搭載チップサイズ: 8.77mm × 8.77mm トレンチ型ゲート マイクロパターントレンチ採用
- ・水路型の放熱構造を採用

Vces=750V Ic=700A 製品リリース日: 2019年2月

レポート内容

① Si-IGBT (750V) Danfoss製 パワーモジュール構造解析レポート

価格36万円(税別) ※46Pのレポートとなります。

- ・概要解析: モジュール外観撮影(水路測長)、X線観察結果
- ・モジュール平面解析: 樹脂除去後、モジュール内レイアウト、各部測長、チップサイズ
- ・モジュール断面解析: 断面研磨+SEM観察+EDXによる組成分析

② Si-IGBT (750V) Danfoss製 パワーモジュール搭載IGBT構造解析レポート

価格40万円(税別) ※61Pのレポートとなります。

- ・概要解析: モジュール外観撮影(水路測長)、X線観察、チップサイズ
- ・IGBTチップ平面レイアウト解析: 各層除膜、レイアウト/パターンの配置・構成
- ・IGBTチップ断面構造解析: 断面構造解析(セル部、チップ端部)

パワーモジュール構造解析レポート

目次

	Page
1. デバイスサマリー	3
1-1. 解析結果まとめ	4
2. モジュール構造解析	
2-1. 外観観察	7
2-2. モジュール内部観察	10
2-3. 搭載チップ観察	14
2-4. モジュール断面観察	15～46

パワーモジュール搭載IGBT構造解析レポート

目次

	Page
1. デバイスサマリー	3
1-1. 解析結果まとめ	4
2. パッケージ解析	
2-1. 外観観察	8
2-2. 搭載チップ観察	14
3. Si IGBTチップ構造解析	
3-1. 平面構造解析(OM)	16
3-2. 平面構造解析(SEM)	32
3-3. セル領域 断面構造解析	45
3-4. 外周部 断面構造解析	52～61